

SnPbAg0.4 4-5M097

免清洗焊膏

介绍

SnPbAg0.4 4-5M097焊膏是新加坡朝日公司研发的特别适用于细间距的表面贴装应用的焊膏，间距尺寸可达到16mil。此焊膏使用无卤化物的助焊剂和低氧化焊粉，有极好的沉积效果，无冷热塌陷现象，在预热阶段可预防焊膏塌陷。

特性：

- 极好的印刷均一性
- 印刷寿命长
- 不存在任何冷热塌陷
- 在渡铜和镀镍基板上都有极好的可焊性和润湿性

应用

SnPbAg0.4 4-5M097 适用于普通钢网印刷，印刷速度设置为 25 - 100 mm/sec。最适于印刷的环境：温度为23 - 25 °C，湿度为 50 - 65 %RH。在这种环境中钢网寿命（取决于操作）在24小时以上。焊膏适用于0.4mm间距操作。根据不同的工艺需求进行必要的调整。

产品特性

| 测试 | 测试成绩 |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 合金 | |
| 合金 | Sn62.8/Pb36.8/Ag0.4 |
| 熔点 | 179 - 183°C |
| Differential Scanning Calorimetry | |
| 粉末尺寸 | 20 - 38 μm, Type IV, |
| IPC TM-650 2.2.14 | 钢网尺寸 -400 / +635 |
| 焊膏助焊剂 | |
| 卤化物含量 | 未检测到 |
| JIS Z 3197 8.1.4.2.1 | |
| 水萃取电阻率 | > 1 x 10 ⁵ Ω-cm |
| JIS Z 3197 8.1.1 | |
| 铜镜测试 | “L”级，合格 |
| IPC-TM-650 2.3.32 | |
| 铜腐蚀测试 | 合格 |
| IPC-TM-650 2.6.15 | |
| 助焊剂活性类别 | ROLO |
| IPC J-STD-004 | |

Solder Paste

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 粘度 | 750 +/- 250 kcPs |
| IPC-TM-650 2.4.34 | |
| JIS Z 3284 Annex 6 | 110 - 220 Pa.s |
| 摇溶现象指数 | 0.40 - 0.80 |
| 粘度测试 | > 24hrs (> 100gf) |
| JIS Z 3284 Annex 9 | |
| 表面绝缘电阻 | > 1 x 10 ⁸ Ω, 合格 |
| (85°C, 85%RH, 168小时) | |
| IPC-TM-650 2.6.3.3 | |
| 电迁移 | 合格 |
| (85°C, 88.5%RH, 596小时) | |
| IPC-TM-650 2.6.14.1 | |
| JIS Z 3284 Annex 14 | |
| 塌陷测试 | 通过 |
| JIS Z 3284 Annex 7, Annex 8 | |
| 焊球测试 | 通过 |
| IPC-TM-650 2.4.43 | |
| 残余干燥测试 | 通过 |
| JIS Z 3284 Annex 12 | |

